



ООО «Остек-ЭТК»

Молодогвардейская ул., д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru, etc@ostec-group.ru
ИНН 7731481052, КПП 773101001, ОГРН 5147746189058,
ОКПО 17183453

Автоматические системы совмещения пластин EVG SmartView® и EVG SmartView® NT



Описание

EVG SmartView® и EVG SmartView®NT — автоматические системы совмещения пластин, которые позволяют работать с подложками различных размеров, начиная от 50 мм и до 300 мм.

Огромное разнообразие конфигураций систем совмещения обеспечивает множество преимуществ для различных применений MEMS и IC.

Системы совмещения EVG могут быть оснащены автоматическими системами передачи пластин. Вместе с системой автовыравнивания данные системы совмещения становятся полностью автоматизированными без возможности открытого доступа и ручного управления.

Большое количество различных методов совмещения может поддерживаться при использовании прямых (режим настоящего времени) либо косвенных методов совмещения.

Уникальные особенности

- Универсальная система совмещения пластин перед сваркой
- Не требует перемещения по оси Z и рефокусирования
- Позволяет работать с пластинами и подложками размером до 300 мм с различной толщиной и материалом
- Интерфейс на основе ОС Windows
- Превосходная параллельность между верхней и нижней пластинами гарантируется трехшпindelной системой клиновой компенсации
- Выравненные пластины фиксируются (зжимаются) перед загрузкой в камеру сварки
- В системе используется бесконтактный перенос пластин
- Возможность автоматического совмещения и фиксации
- Возможность интеграции в автоматизированную систему совмещения и сварки (GEMINI)

EVG SmartView® можно комбинировать с системой сварки пластин серии EVG500, с системой очистки серии EVG300 и системой плазменной активации EVG810LT, чтобы получить автоматическую систему совмещения пластина-к-пластине при передаче пластин из кассеты в кассету.

EVG SmartView® позволяет производить прямую сварку пластин из кремния. SmartView®NT предлагает возможность совмещения «лицо-к-лицу», которая не требует реперных знаков для совмещения по задней стороне и подложки с двухсторонней полировкой.

Система проста в работе благодаря интерфейсу на основе ОС Windows. В системе может быть сохранено неограниченное число процессов, включая значения основных и продвинутых параметров процесса, таких как конфигурация микроскопа и его положение.

Технические характеристики

Технические характеристики	EVG SmartView®	EVG SmartView®NT
Размеры пластины / подложки	50 — 150, 150 — 200, 200 — 300 мм	150 — 200, 200 — 300 мм
Толщина	0,2 — 1,5 мм для каждой пластины	0,1 — 5 мм
Максимальная толщина пакета	До 12 мм	До 10 мм
Метод совмещения		
SmartView®	± 1,3 мкм	± 0,5 мкм
По нижней стороне	± 2,0 мкм	± 0,5 мкм

Просвечивающее совмещение	$\pm 0,5$ мкм	$\pm 0,3$ мкм
Просвечивающее ИК-совмещение	Опция (зависит от типа подложки)	
Координатный стол		
Микрометрические винты	Моторизированные	
Клиновая компенсация	Автоматическая	
Виброизоляция	Активная	
Автоматизация		
Автоматическое совмещение	Входит в стандартную комплектацию	
Система передачи	Трехкассетная станция (до 200 мм) 2 порта загрузки (до 300 мм)	